

**Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

---

**Направление подготовки/специальность: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника**

**Наименование образовательной программы: Микроэлектроника и твердотельная электроника**

**Уровень образования: высшее образование - бакалавриат**

**Форма обучения: Очная**

**Рабочая программа дисциплины  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ**

<b>Блок:</b>	<b>Блок 1 «Дисциплины (модули)»</b>
<b>Часть образовательной программы:</b>	<b>Часть, формируемая участниками образовательных отношений</b>
<b>№ дисциплины по учебному плану:</b>	<b>Б1.Ч.01.15</b>
<b>Трудоемкость в зачетных единицах:</b>	<b>8 семестр - 5;</b>
<b>Часов (всего) по учебному плану:</b>	<b>180 часов</b>
<b>Лекции</b>	<b>не предусмотрено учебным планом</b>
<b>Практические занятия</b>	<b>8 семестр - 70 часов;</b>
<b>Лабораторные работы</b>	<b>не предусмотрено учебным планом</b>
<b>Консультации</b>	<b>проводится в рамках часов аудиторных занятий</b>
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>8 семестр - 109,7 часов;</b>
<b>в том числе на КП/КР</b>	<b>не предусмотрено учебным планом</b>
<b>Иная контактная работа</b> <b>включая:</b> <b>Контрольная работа</b>	<b>проводится в рамках часов аудиторных занятий</b>
<b>Промежуточная аттестация:</b>	
<b>Зачет с оценкой</b>	<b>8 семестр - 0,3 часа;</b>

**Москва 2024**

**ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:**

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ		
Владелец	Зезин Д.А.	
Идентификатор	Re7522a00-ZezinDA-ba8dbd73	

Д.А. Зезин

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель  
образовательной программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ		
Владелец	Баринов А.Д.	
Идентификатор	Ra98e1318-BarinovAD-f138ec4f	

А.Д. Баринов

Заведующий выпускающей  
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ		
Владелец	Зезин Д.А.	
Идентификатор	Re7522a00-ZezinDA-ba8dbd73	

Д.А. Зезин

## **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Цель освоения дисциплины:** состоит в углублённом изучении физических основ и разновидностей полупроводниковых приборов и компонентов интегральных схем, их принципа действия, основных параметров и характеристик, области применения

### **Задачи дисциплины**

- развитие способности учитывать физические основы работы полупроводниковых приборов и интегральных схем, применяемых в приборах и устройствах электроники и наноэлектроники, современные тенденции развития электроники;

- освоение способности строить простейшие физические и математические модели полупроводниковых приборов и интегральных схем, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования;

- развитие способности аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов и интегральных схем;

- развитие готовности анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчётов.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

<b>Код и наименование компетенции</b>	<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Запланированные результаты обучения</b>
ПК-1 Способен участвовать в проектировании интегральных схем	ИД-1пк-1 Использует средства автоматизации схемотехнического проектирования	знать: - методы оптимизации параметров полупроводниковых интегральных схем.  уметь: - экстрагировать параметры моделей из эксперимента.
ПК-2 Способен осуществлять расчет и проектирование полупроводниковых приборов и устройств, проводить моделирование и анализ с использованием средств автоматизации проектирования	ИД-1пк-2 Демонстрирует знание принципов работы, физических и математических моделей основных полупроводниковых приборов	знать: - методы оптимизации параметров полупроводниковых полевых транзисторов.  уметь: - оптимизировать конструкцию полевых транзисторов для достижения требуемых параметров.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО**

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Микроэлектроника и твердотельная электроника (далее – ОПОП), направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.



### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы											Содержание самостоятельной работы/ методические указания		
				Контактная работа						СР							
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль				
							КПР	ГК	ИККП	ТК							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		
1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры	35.7	8	-	-	14	-	-	-	-	-	21.7	-			<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 133-190, 410-428 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], с. 133-190, 410-428	
1.1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры	35.7		-	-	14	-	-	-	-	-	21.7	-				
2	Модели полевых элементов ИС	36		-	-	16	-	-	-	-	-	20	-			<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 301-367 [2], с. 2-26 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], с. 301-367 [2], с. 2-26 [4], с. 2-26	
2.1	Модели полевых элементов ИС	36		-	-	16	-	-	-	-	-	20	-				
3	Модели короткоканальных полевых ИС	36		-	-	16	-	-	-	-	-	20	-			<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 301-367 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], с. 191-249 [3], с. 25-36, 223-233	
3.1	Модели короткоканальных полевых ИС	36		-	-	16	-	-	-	-	-	20	-				
4	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности	36		-	-	12	-	-	-	-	-	24	-			<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 191-249 [3], с. 25-36, 223-233 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], с. 301-367	

	функционально ориентированных ИС																		
4.1	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС	36	-	-	12	-	-	-	-	-	24	-							
5	Перспективные транзисторы	36	-	-	12	-	-	-	-	-	24	-	<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [3], с. 25–36, 223–233						
5.1	Перспективные транзисторы	36	-	-	12	-	-	-	-	-	24	-	<u>Изучение материалов литературных источников:</u> [3], с. 25–36, 223–233						
	Зачет с оценкой	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-							
	Всего за семестр	180.0	-	-	70	-	-	-	-	0.3	109.7	-							
	Итого за семестр	180.0	-	-	70	-	-	-	-	0.3	109.7								

**Примечание:** Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

### **3.2 Краткое содержание разделов**

#### 1. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры

1.1. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры

Классификация интегральных схем по элементной базе, полупроводниковому материалу, технологии и схемо-топологическим решениям. Основные базовые элементы и компоненты полупроводниковых интегральных схем. Общие положения математической формулировки задач моделирования физических процессов в элементах интегральных схем. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры. Кинетическое уравнение Больцмана, основные приближения и допущения в моделях элементов ИС. Представление о физико-топологическом и схемотехническом уровнях моделирования ИС..

#### 2. Модели полевых элементов ИС

##### **2.1. Модели полевых элементов ИС**

ИС на основе полевых транзисторов с управляемым р-п переходом. Модель полевого транзистора с произвольным профилем легирования канала. Элементы ИС с МОП - структурой. Полевые транзисторы для МОП ИС. Модель МДП транзистора. Подпороговые характеристики МДП транзисторов. Эффекты сильного поля в канале МДП транзисторов..

#### 3. Модели короткоканальных полевых ИС

##### **3.1. Модели короткоканальных полевых ИС**

МОС-структура с протяженными областями. Короткоканальные полевые транзисторы для МОП ИС. Подпороговые характеристики короткоканальных МДП транзисторов. Короткоканальные эффекты в МДП транзисторах. Подпороговые токи, эффект модуляции барьера истока стоковым напряжением, изменение порогового напряжения. Умножение носителей и зарядка окисла в МДП транзисторах. Инжекционный пробой. Эффект «защёлки» (тиристорный эффект) в КМОП ИС, методы его подавления. Масштабная миниатюризация в МДП ИС и её пределы. Эффекты горячих носителей в короткоканальных МДП приборах и методы подавления этих эффектов. Баллистический режим..

#### 4. Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС

##### **4.1. Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов.**

Особенности функционально ориентированных ИС

Биполярные интегральные схемы на основе гетеропереходов. Особенности ИС на основе GaAs. Барьер Шоттки. Инжекция неосновных носителей. Полевые транзисторы с гетеропереходами. Основные типы конструкций. Нелинейные резисторы в ИС на основе GaAs. Особенности полевых транзисторов на основе широкозонных полупроводников (GaAs, SiC, AlGaN) по сравнению с транзисторами на основе кремния (Si)..

#### 5. Перспективные транзисторы

##### **5.1. Перспективные транзисторы**

Модель двух областей, модель с полностью насыщенной скоростью. Полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов Приборы с зарядовой связью, физические

основы работы. Основные характеристики, верхняя и нижняя рабочие частоты, эффективность переноса. Физика элементов статической памяти на основе структур металло-диэлектрик-(диэлектрик)-полупроводник. Элементы памяти с лавинной инжеекцией заряда. Элементы памяти с двухслойным диэлектриком. Проблемы элементной базы аналоговых ИС, интегральных схем ЦАП-АЦП. Методы экспериментального исследования элементов ИС на стадии разработки и производства. Принципы и приёмы разработки тестовых структур элементов, узлов и микросистем. Представления об автоматизированных системах экспериментальных исследований элементов тестовых структур..

### **3.3. Темы практических занятий**

1. Эффекты горячих носителей в короткоканальных МДП приборах и методы подавления этих эффектов.;
2. Проблемы элементной базы аналоговых ИС, интегральных схем ЦАП-АЦП.;
3. Классификация интегральных схем по элементной базе, полупроводниковому материалу, технологии и схемо-топологическим решениям.;
4. Общие положения математической формулировки задач моделирования физических процессов в элементах интегральных схем.;
5. Основные базовые элементы и компоненты полупроводниковых интегральных схем.;
6. Инжекционный пробой. Эффект «защёлки» (тиристорный эффект) в КМОП ИС, методы его подавления.;
7. Принципы и приёмы разработки тестовых структур элементов, узлов и микросистем. Представления об автоматизированных системах экспериментальных исследований элементов тестовых структур;
8. Элементы ИС с МОП - структурой. Полевые транзисторы для МОП ИС. Модель МДП транзистора.;
9. Подпороговые токи, эффект модуляции барьера истока стоковым напряжением, изменение порогового напряжения.;
10. Короткоканальные эффекты в МДП транзисторах.;
11. Подпороговые характеристики короткоканальных МДП транзисторов.;
12. Короткоканальные полевые транзисторы для МОП ИС.;
13. МОС-структура с протяженными областями.;
14. Умножение носителей и зарядка окисла в МДП транзисторах.;
15. Модель полевого транзистора с произвольным профилем легирования канала.;
16. Баллистический режим. Биполярные интегральные схемы на основе гетеропереходов.;
17. ИС на основе полевых транзисторов с управляющим р-п переходом. .;
18. Особенности полевых транзисторов на основе широкозонных полупроводников (GaAs, SiC, AlGaN) по сравнению с транзисторами на основе кремния (Si).;
19. Представление о физико-топологическом и схемотехническом уровнях моделирования ИС.;
20. Кинетическое уравнение Больцмана, основные приближения и допущения в моделях элементов ИС.;
21. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры.;
22. Подпороговые характеристики МДП транзисторов.;
23. Методы экспериментального исследования элементов ИС на стадии разработки и производства..

### **3.4. Темы лабораторных работ**

не предусмотрено

### **3.5 Консультации**

### **3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ**

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

### **3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций**

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)					Оценочное средство (тип и наименование)	
		1	2	3	4	5		
<b>Знать:</b>								
методы оптимизации параметров полупроводниковых интегральных схем	ИД-1ПК-1		+		+	+	Контрольная работа/Опрос № 2	
методы оптимизации параметров полупроводниковых полевых транзисторов	ИД-1ПК-2	+		+			Контрольная работа/Опрос № 1	
<b>Уметь:</b>								
экстрагировать параметры моделей из эксперимента	ИД-1ПК-1				+	+	Контрольная работа/Опрос № 4	
оптимизировать конструкцию полевых транзисторов для достижения требуемых параметров	ИД-1ПК-2	+	+	+			Контрольная работа/Опрос № 3	

## **4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)**

### **4.1. Текущий контроль успеваемости**

**8 семестр**

Форма реализации: Защита задания

1. Опрос № 4 (Контрольная работа)

Форма реализации: Проверка задания

1. Опрос № 1 (Контрольная работа)
2. Опрос № 2 (Контрольная работа)
3. Опрос № 3 (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

### **4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине**

Зачет с оценкой (Семестр №8)

Оценка выставляется по результатам текущего контроля в соответствии с БАРС

В диплом выставляется оценка за 8 семестр.

**Примечание:** Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

## **5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **5.1 Печатные и электронные издания:**

1. Твердотельная электроника : учебное пособие для вузов по направлению "Электроника и микроэлектроника" / Э. Н. Воронков, [и др.] . – М. : АКАДЕМИЯ, 2009 . – 320 с. – (Высшее профессиональное образование) . - ISBN 978-5-7695-4618-1 .;
2. Шалимова, К. В. Физика полупроводников : учебник / К. В. Шалимова . – 4-е изд., стер . – М. : Лань-Пресс, 2010 . – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . - ISBN 978-5-8114-0922-8 .;
3. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для вузов по направлению 210100 "Электроника и микроэлектроника" / В. И. Старосельский . – М. : Юрайт, 2014 . – 463 с. – (Основы наук) . - ISBN 978-5-9916-0808-4 .;
4. Шалимова К. В.- "Физика полупроводников", (4-е изд., стер.), Издательство: "Лань", Санкт-Петербург, 2021 - (384 с.)  
<https://e.lanbook.com/book/167840>.

### **5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:**

1. Office / Российский пакет офисных программ;
2. ОС Linux.

### **5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:**

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" -  
[http://biblioclub.ru/index.php?page=main\\_ub\\_red](http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red)  
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	K-105/1, Компьютерный класс	стол, стол для оргтехники, стол компьютерный, стул, доска меловая, мультимедийный проектор, компьютер персональный, кондиционер
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	K-105/1, Компьютерный класс	стол, стол для оргтехники, стол компьютерный, стул, доска меловая, мультимедийный проектор, компьютер персональный, кондиционер
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	K-105/1, Компьютерный класс	стол, стол для оргтехники, стол компьютерный, стул, доска меловая, мультимедийный проектор, компьютер персональный, кондиционер
Помещения для самостоятельной работы	НТБ-302, Читальный зал отдела обслуживания учебной литературой	стул, стол письменный, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный
Помещения для консультирования	K-109/2, Кабинет сотрудников каф. "ЭиН"	стол, стул, шкаф для документов, шкаф для хранения инвентаря, стол письменный, дипломные и курсовые работы студентов
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	K-115, Склад каф. "ЭиН"	стеллаж, инвентарь учебный

**БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ****Проектирование элементов интегральных схем**

(название дисциплины)

**8 семестр****Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:**

КМ-1 Опрос № 1 (Контрольная работа)

КМ-2 Опрос № 2 (Контрольная работа)

КМ-3 Опрос № 3 (Контрольная работа)

КМ-4 Опрос № 4 (Контрольная работа)

**Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.**

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	KM-1	KM-2	KM-3	KM-4
		Неделя КМ:	2	8	12	16
1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры					
1.1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры	+		+		
2	Модели полевых элементов ИС					
2.1	Модели полевых элементов ИС			+	+	
3	Модели короткоканальных полевых ИС					
3.1	Модели короткоканальных полевых ИС	+			+	
4	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС					
4.1	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС			+		+
5	Перспективные транзисторы					
5.1	Перспективные транзисторы			+		+
Вес КМ, %:			10	20	20	50